

東京エレクトロン

2010年3月期 決算説明会

2010年5月12日

資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



東京エレクトロン

2010年3月期 決算概要

執行役員 七澤 豊

2010年 5月12日



東京エレクトロン

2010年3月期 決算(連結) 2010年3月期業績

(単位:億円)

	2009年3月期	2010年3月期	対前年増減額	対前年増減率
売上高	5,080	4,186	-894	-17.6%
SPE	3,253	2,623	-629	-19.4%
FPD/PVE	881	713	-167	-19.0%
EC/CN	942	844	-97	-10.3%
その他	3	4	+0	+6.8%
売上総利益	1,374 (27.0%)	1,083 (25.9%)	-290	-21.2%
販管費	1,226	1,104	-122	-9.9%
営業利益	147 (2.9%)	-21 (-0.5%)	-168	-
経常利益	205	25	-179	-87.6%
税前利益	96	-77	-174	-
当期純利益	75	-90	-165	-

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. ()内は利益率
3. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています



2010年3月期 決算(連結)
2010年3月期業績

(単位:億円)

	2009年3月期			2010年3月期		
	上期	下期	合計	上期	下期	合計
売上高	3,012	2,068	5,080	1,538	2,647	4,186
SPE	2,087	1,166	3,253	821	1,802	2,623
FPD/PVE	401	479	881	307	406	713
EC/CN	521	420	942	407	436	844
その他	2	1	3	2	1	4
売上総利益	910 (30.2%)	463 (22.4%)	1,374 (27.0%)	308 (20.1%)	774 (29.3%)	1,083 (25.9%)
販管費	647	579	1,226	524	580	1,104
営業利益	262 (8.7%)	-115 (-5.6%)	147 (2.9%)	-216 (-14.0%)	194 (7.3%)	-21 (-0.5%)
経常利益	289	-83	205	-192	217	25
税前利益	286	-190	96	-262	184	-77
当期純利益	173	-98	75	-161	71	-90

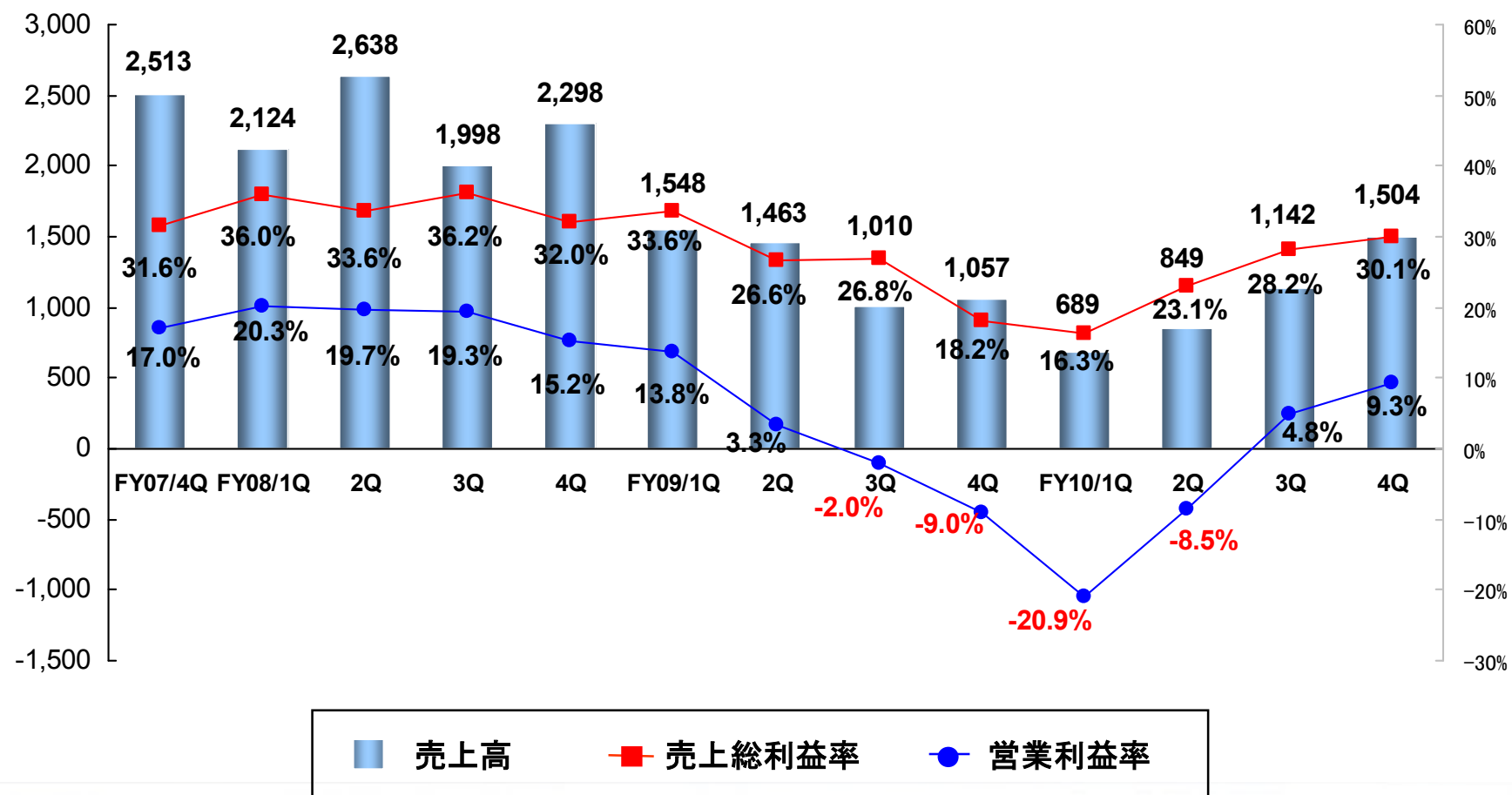
半導体製造装置の売上増加により、下期業績が大幅に改善



2010年3月期 決算(連結)

売上・利益率推移

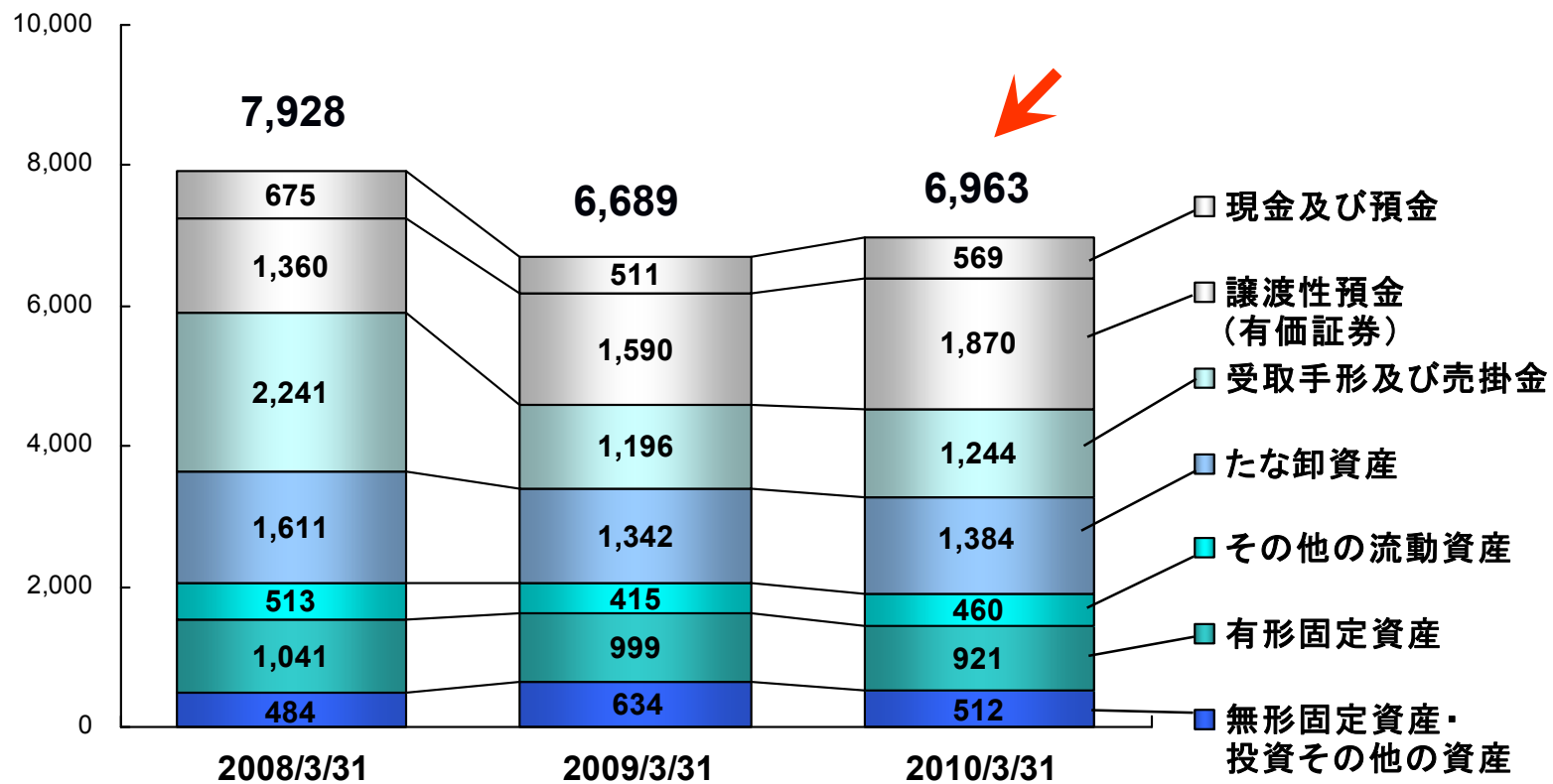
(単位: 億円)



2010年3月期 決算(連結)

資産

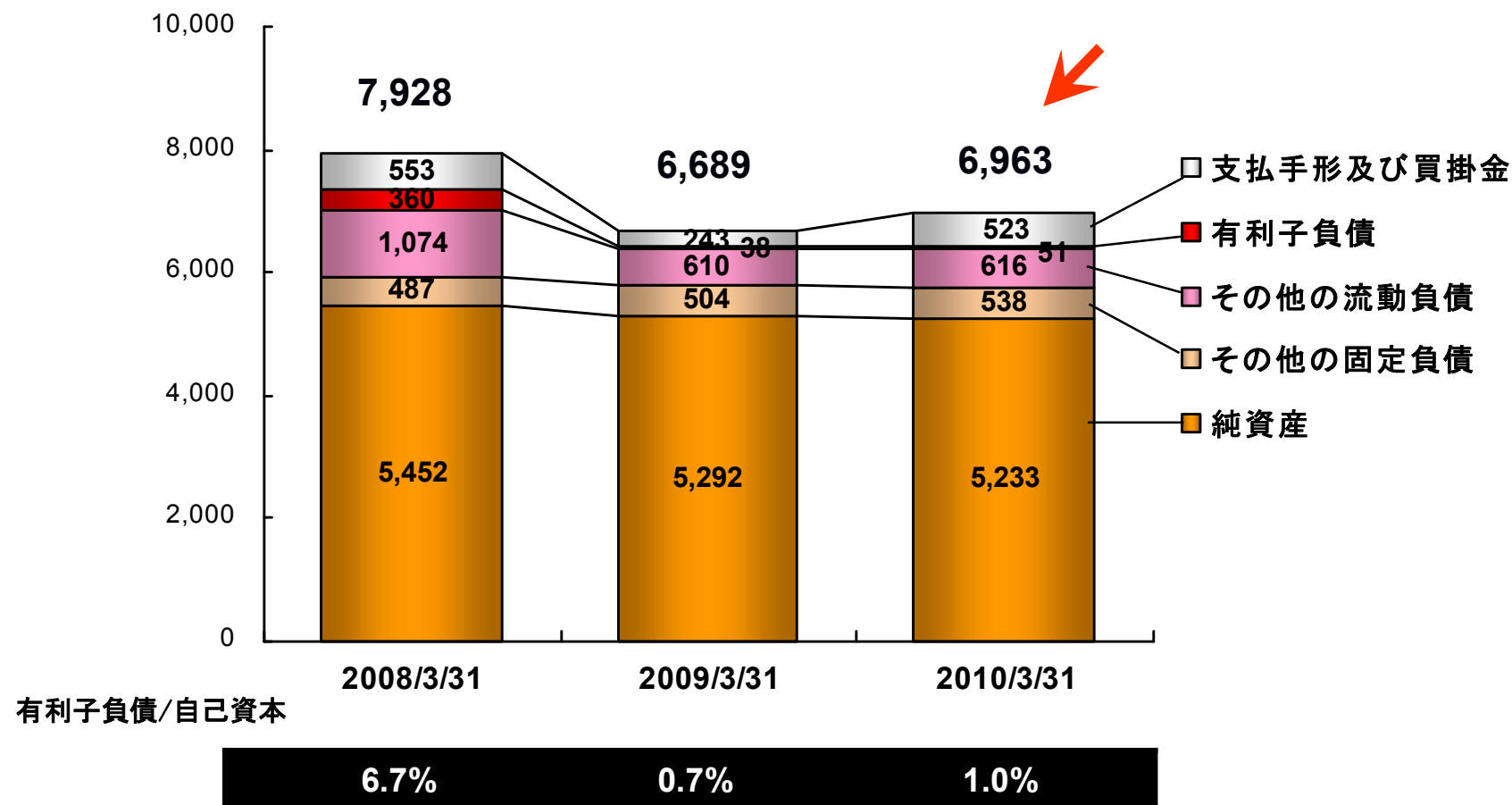
(単位:億円)



2010年3月期 決算(連結)

負債・純資産

(単位:億円)

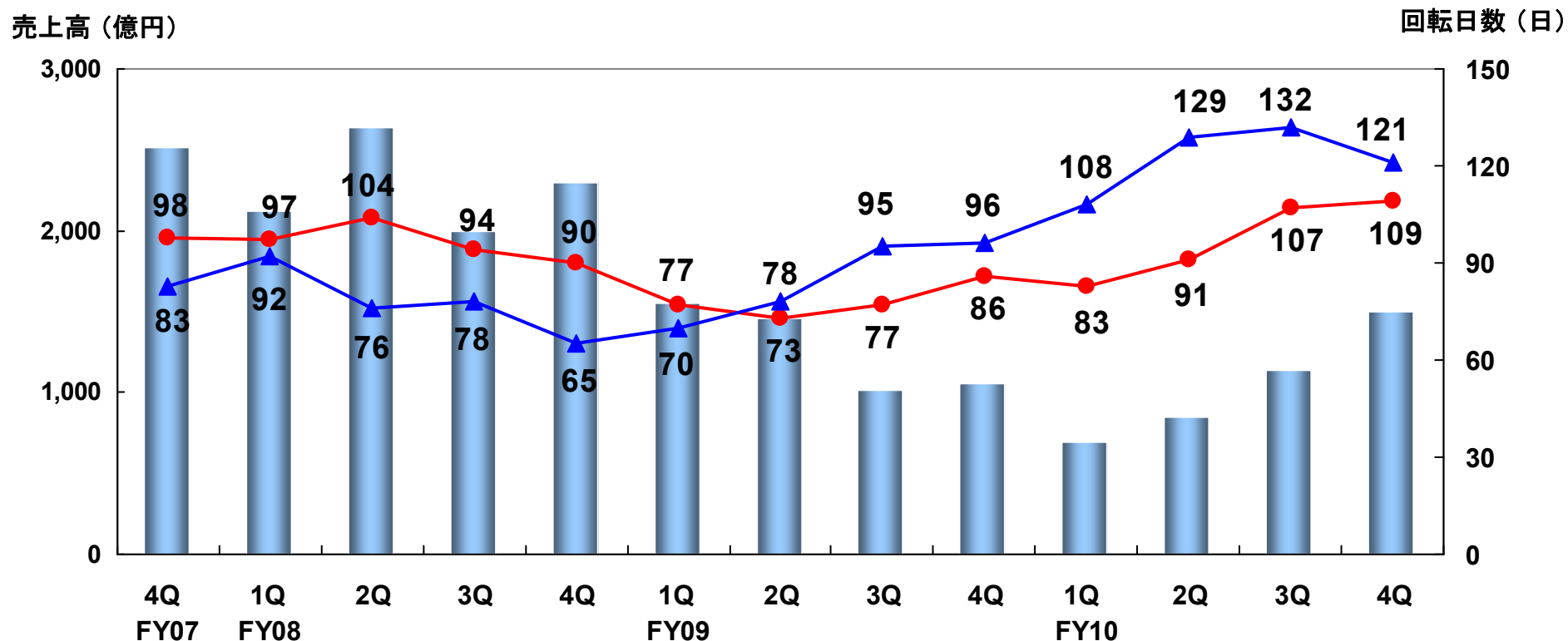
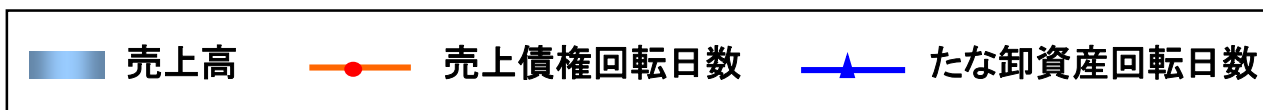


*自己資本＝純資産-(新株予約権+少数株主持分)



2010年3月期 決算(連結)

たな卸資産・売上債権の回転日数



*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



2010年3月期 決算(連結)

キャッシュ・フロー

(単位:億円)



		2008/3	2009/3	2010/3
営業活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		1,169	810	482
	税金等調整前当期純利益	1,692	96	▲77
	減価償却費	214	230	200
	仕入債務、売上債権、棚卸資産の増減	34	937	182
	その他	▲771	▲454	178
投資活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		▲301	▲1,606	96
	設備投資等	▲150	▲165	▲137
	その他(3ヶ月超の預金への預入等)	▲151	▲1,440	233
財務活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		▲270	▲460	▲2
	有利子負債の増加(▲:減少)	▲41	▲322	12
	配当金	▲234	▲134	▲14
	その他	5	▲3	▲1
現金及び現金同等物に係る換算差額		▲6	▲20	4
現金及び現金同等物の増加額(▲:減少)		591	▲1,276	580
現金及び現金同等物の期首残高		1,343	1,934	658
現金及び現金同等物の期末残高		1,934	658	1,239
(ご参考)現預金及び譲渡性預金の期末残高		2,035	2,101	2,439

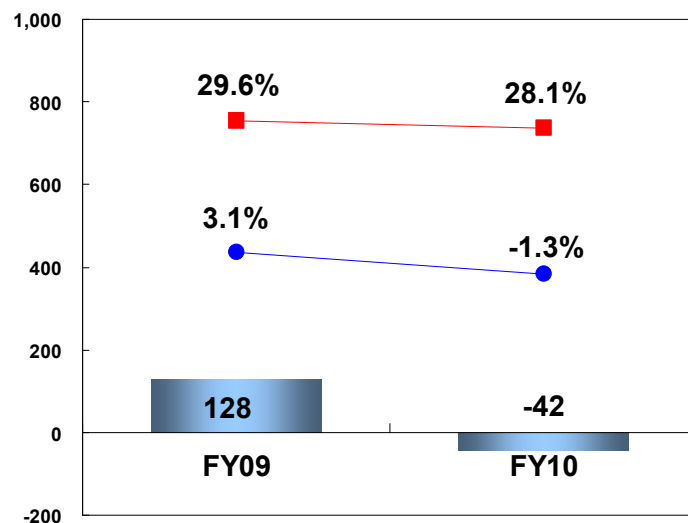


事業の種類別セグメント情報

産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、
太陽電池製造装置、その他)

(単位: 億円)

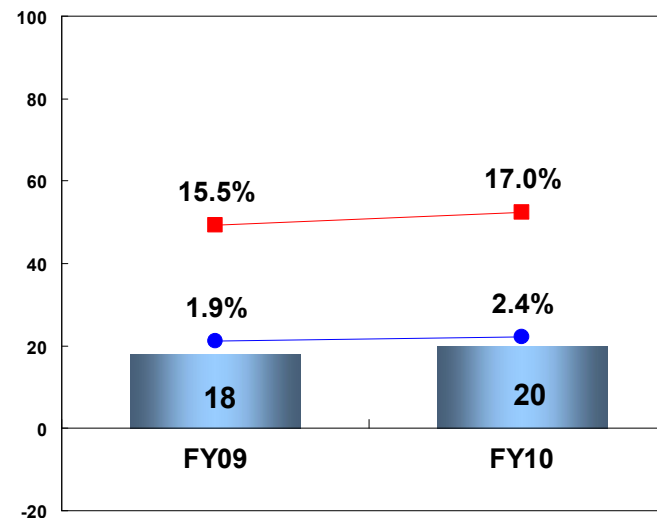


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

電子部品・情報通信機器

(半導体製品、その他電子部品、
コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア)

(単位: 億円)



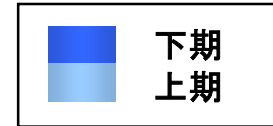
■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

*セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



2010年3月期 決算(連結)

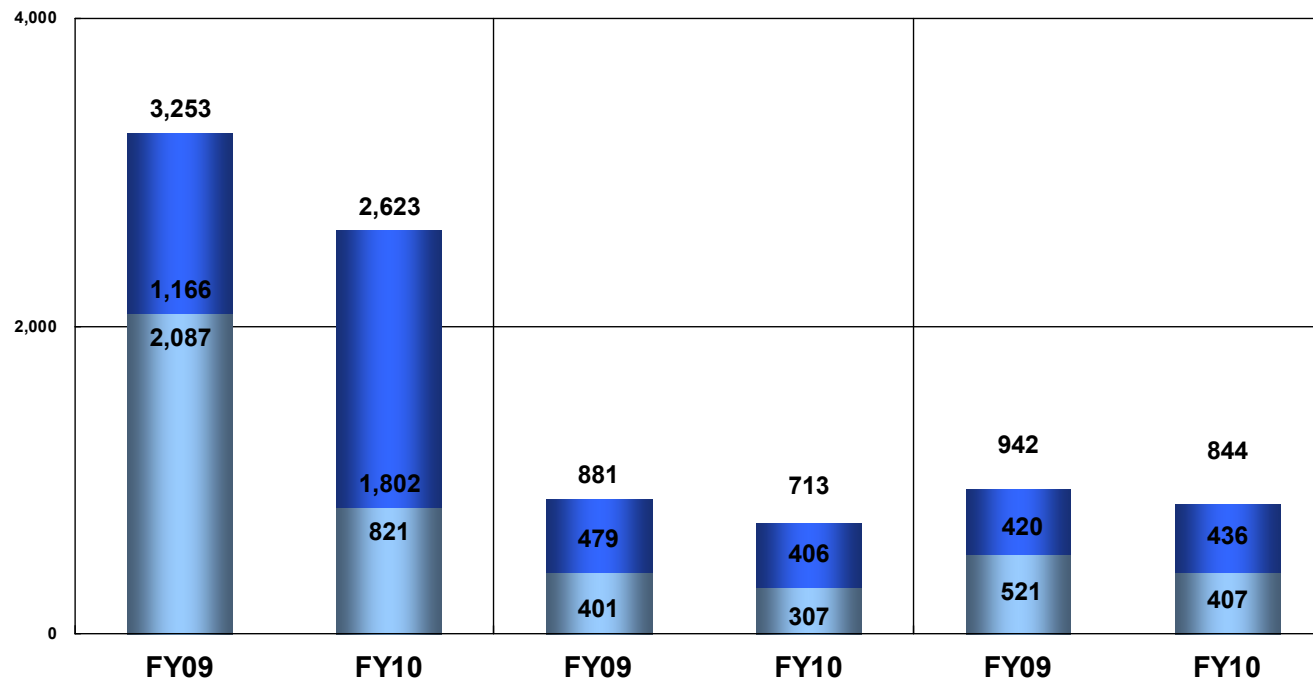
部門別売上高



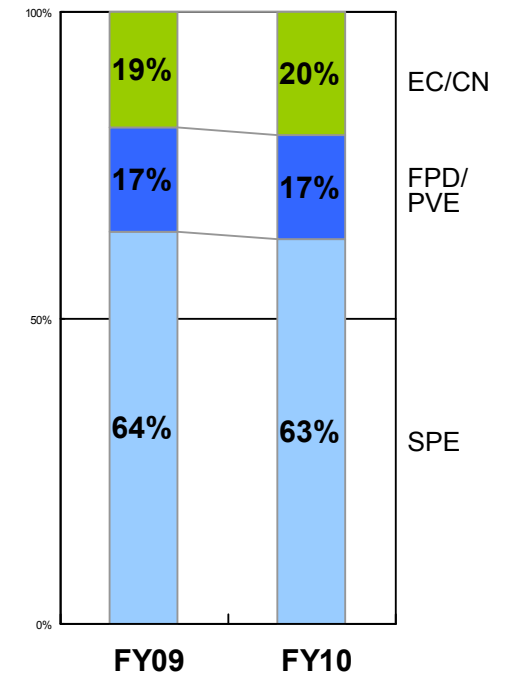
SPE部門

(半導体製造装置)

(単位: 億円)



部門別構成比



[通期前年比]

-19.4%

-19.0%

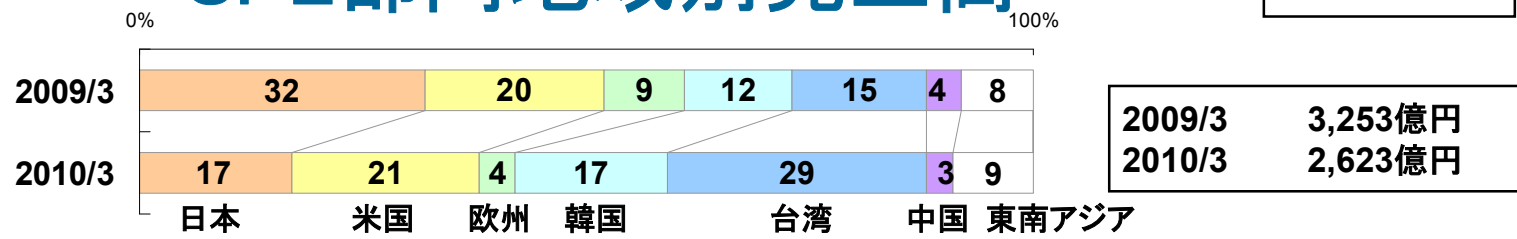
-10.3%

* これら3部門の売上以外に「その他」の売上があります。



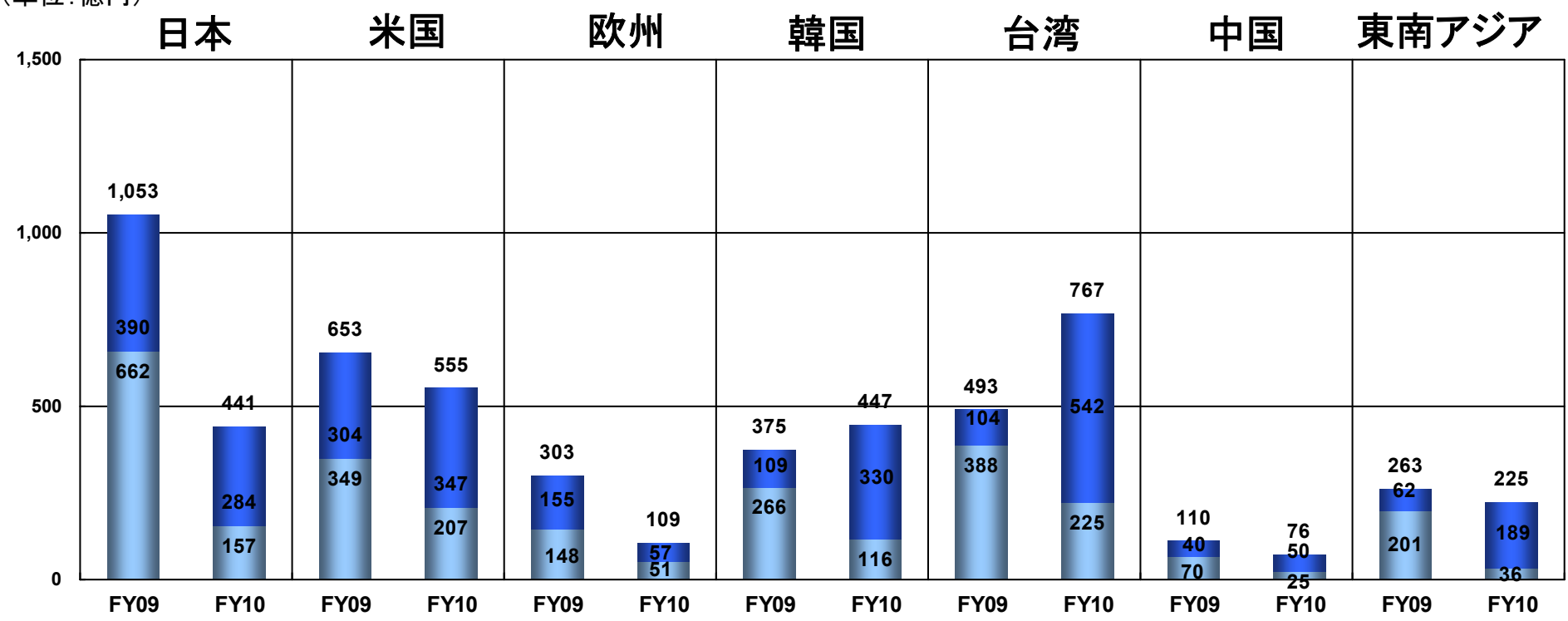
2010年3月期 決算(連結) SPE部門地域別売上高

■ 下期
■ 上期



2009/3 3,253億円
2010/3 2,623億円

(単位:億円)



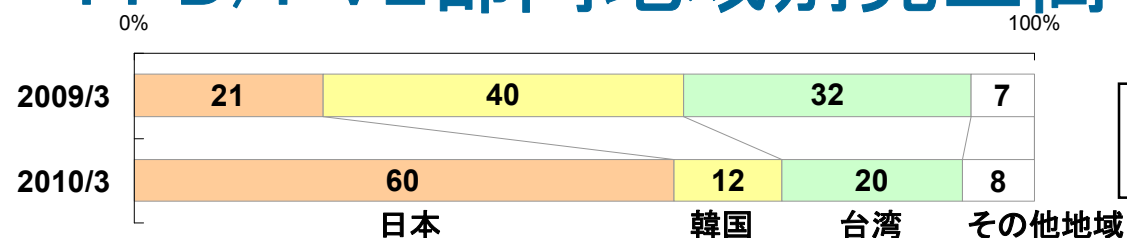
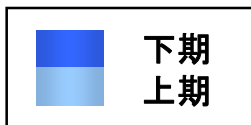
[通期前年比]

-58.1% **-15.0%** **-64.0%** **19.1%** **55.7%** **-31.3%** **-14.2%**



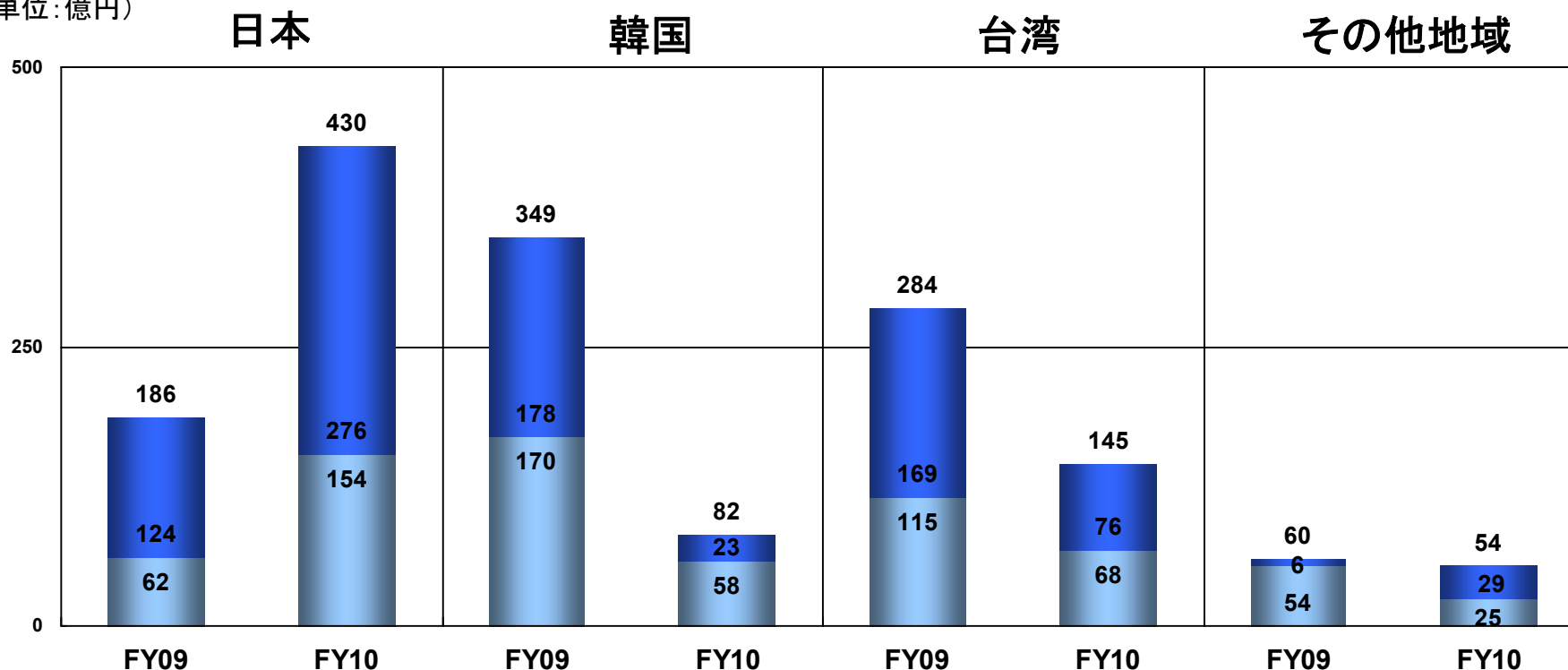
2010年3月期 決算(連結)

FPD/PVE部門地域別売上高



2009/3	881億円
2010/3	713億円

(単位: 億円)

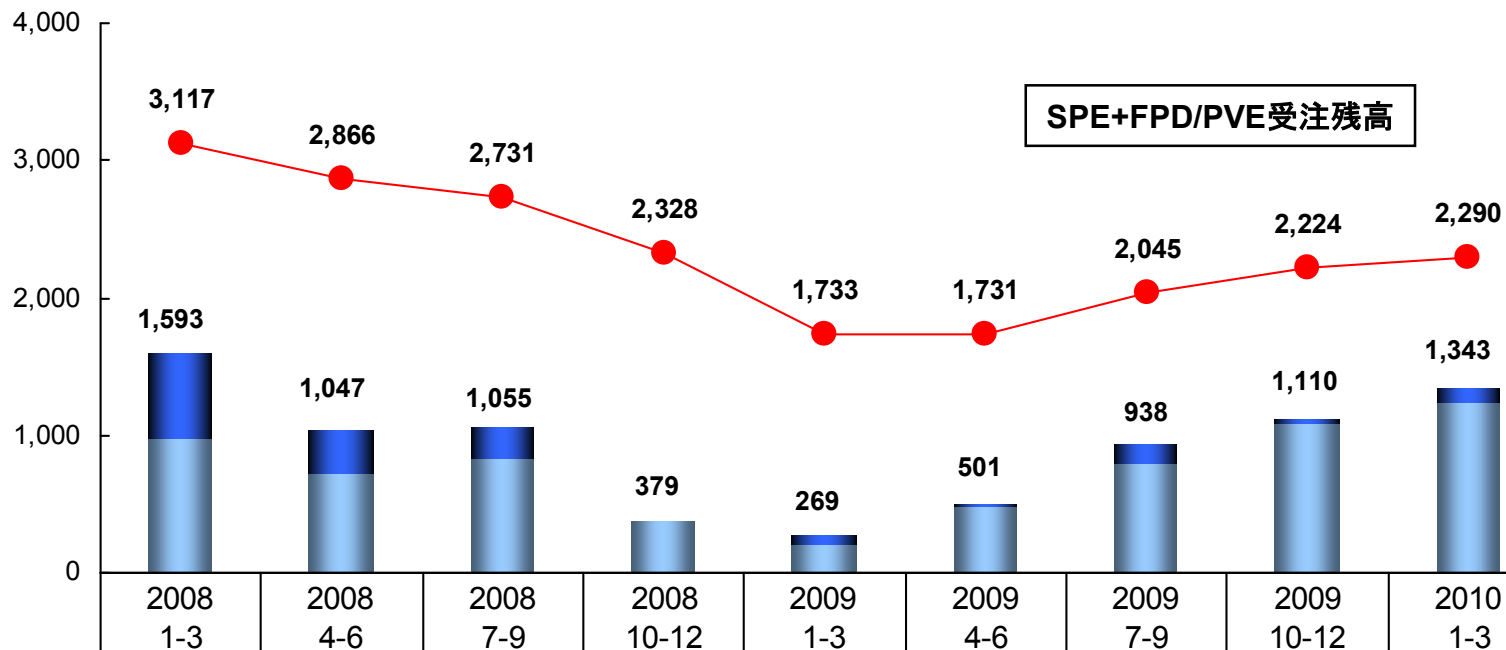


[通期前年比]



四半期 SPE+FPD/PVE受注額, 受注残高

(単位: 億円)



	2008 1-3	2008 4-6	2008 7-9	2008 10-12	2009 1-3	2009 4-6	2009 7-9	2009 10-12	2010 1-3
■ FPD/PV製造装置 受注額	610	319	217	4	64	14	142	22	106
■ 半導体製造装置 受注額	983	727	837	375	204	487	796	1,088	1,236
● 受注残高	3,117	2,866	2,731	2,328	1,733	1,731	2,045	2,224	2,290

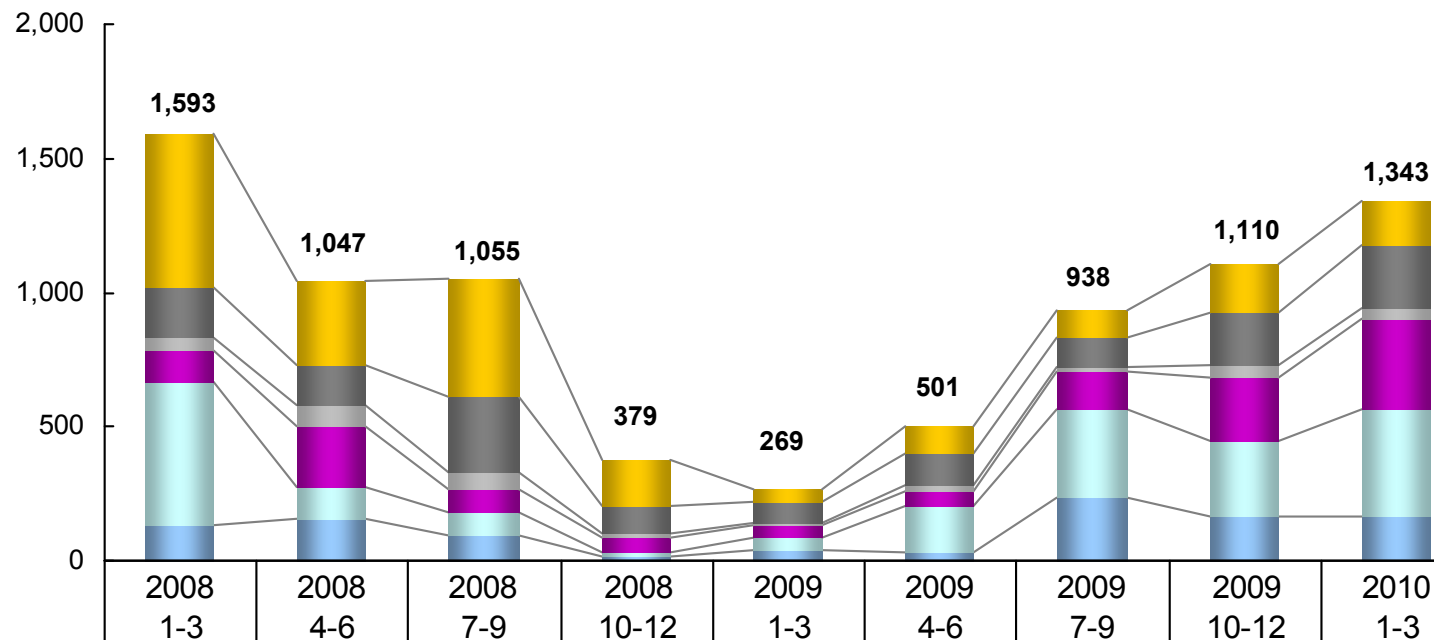
受注残高内訳	FPD/PVE	1,271	1,417	1,406	1,206	995	810	844	700	567
	SPE	1,846	1,448	1,325	1,122	737	920	1,200	1,523	1,723



2010年3月期 決算(連結)

四半期 地域別 SPE+FPD/PVE受注額

(単位: 億円)



■ 国内	574	318	444	173	46	101	102	181	168
■ 米国	184	143	281	104	82	118	110	202	233
■ 欧州	49	79	59	15	1	19	22	45	38
■ 韓国	113	228	90	56	51	56	137	234	343
■ 台湾	534	121	88	12	45	175	331	284	400
■ 中国・東南ア他	136	156	91	17	41	30	234	163	161



四半期決算の推移



2010年3月期 決算(連結) 業績推移

(単位:億円)

	2010年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
売上高	689	849	1,142	1,504	4,186
売上総利益	111 (16.3%)	196 (23.1%)	322 (28.2%)	452 (30.1%)	1,083 (25.9%)
販管費	255	269	267	312	1,104
営業利益	-143 (-20.9%)	-72 (-8.5%)	55 (4.8%)	139 (9.3%)	-21 (-0.5%)
経常利益	-140	-51	65	151	25
税前利益	-184	-78	37	147	-77
当期純利益	-110	-51	-0	71	-90

研究開発費	121	130	132	156	540
設備投資額	11	70	16	50	149
減価償却実施額	49	49	50	50	200

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

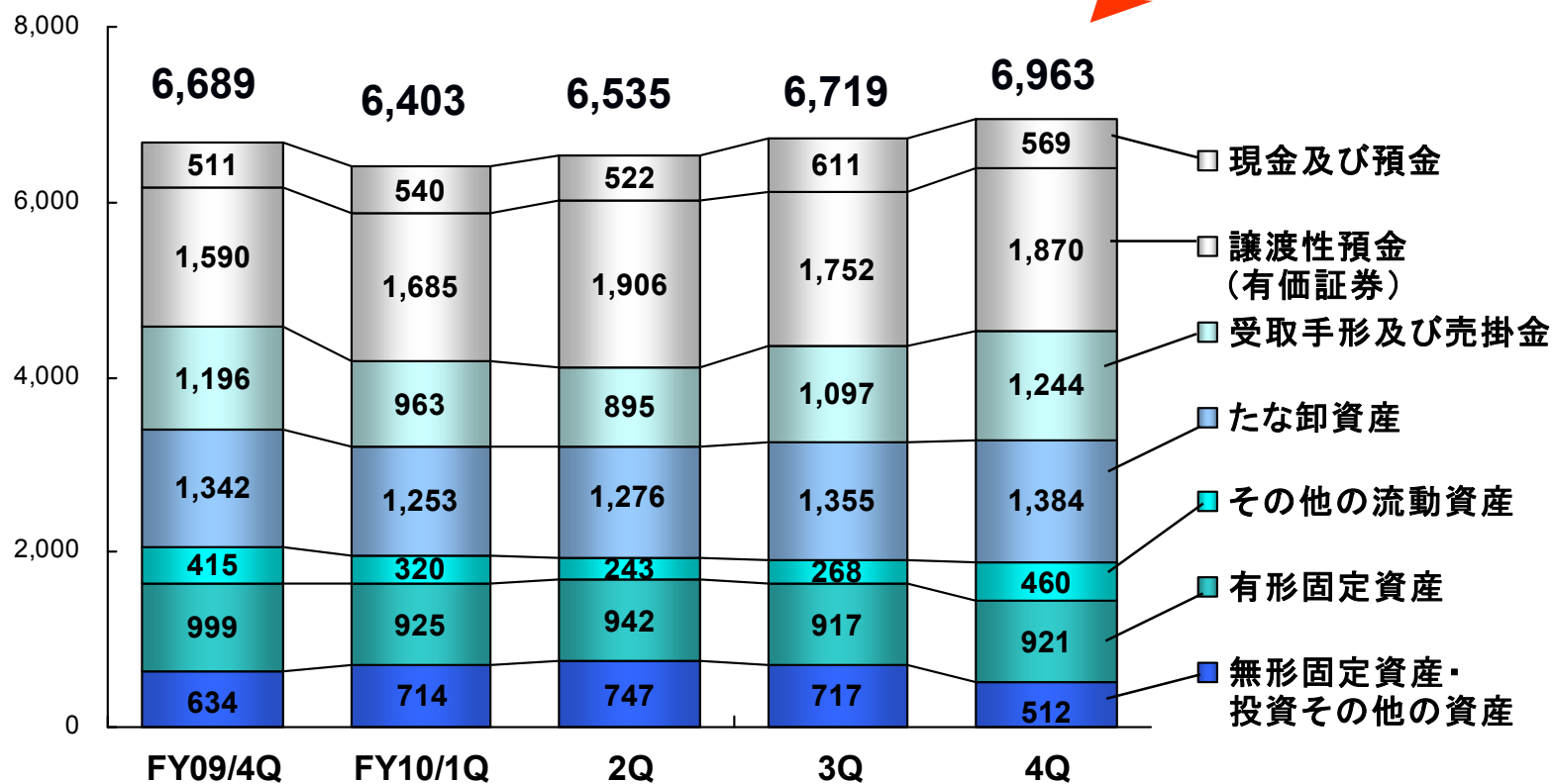
1. ()内は利益率
2. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています



2010年3月期 決算(連結)

資産

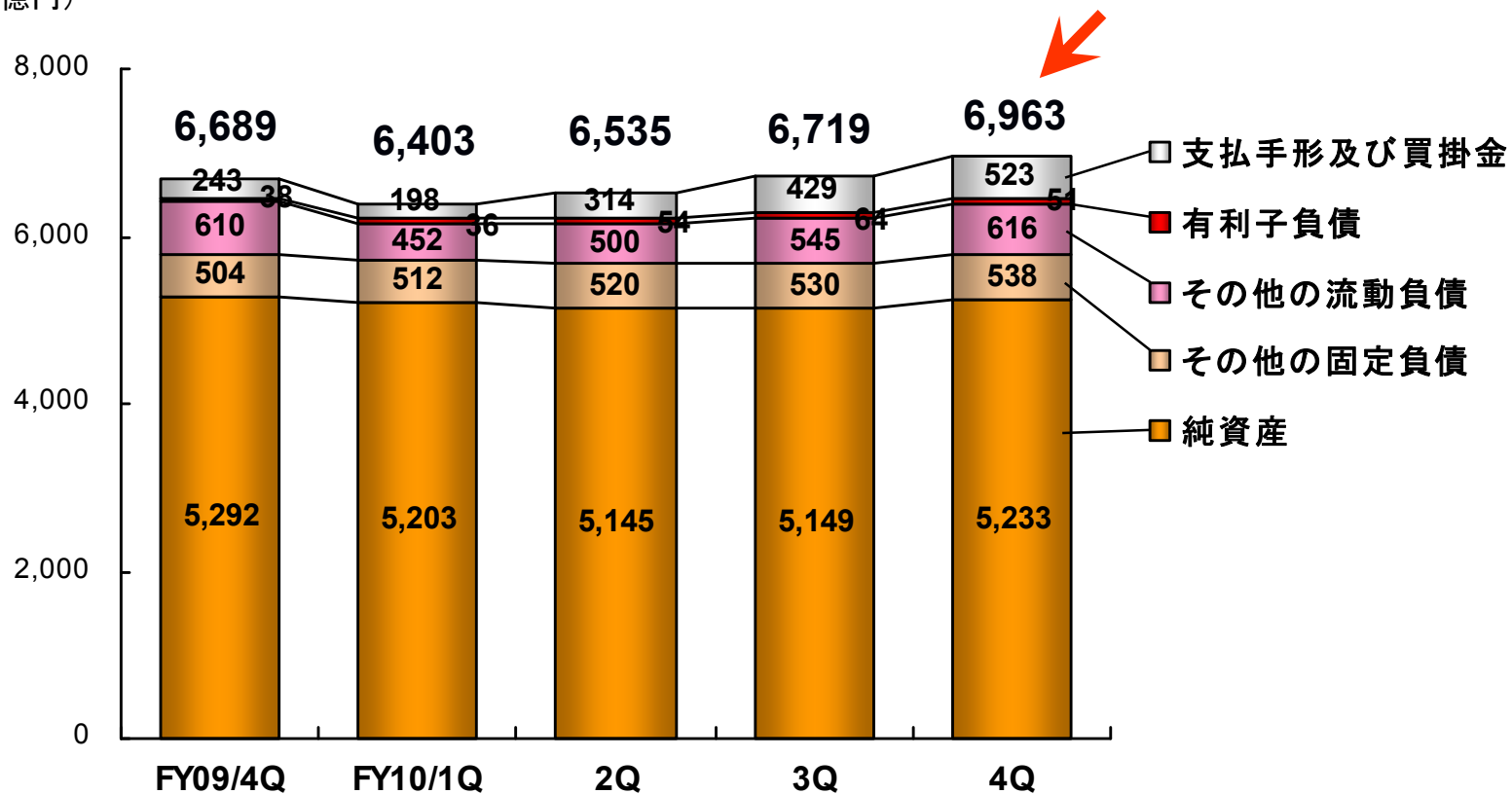
(単位: 億円)



2010年3月期 決算(連結)

負債・純資産

(単位:億円)



有利子負債/自己資本

0.7% 0.7% 1.1% 1.3% 1.0%

*自己資本＝純資産-(新株予約権+少数株主持分)

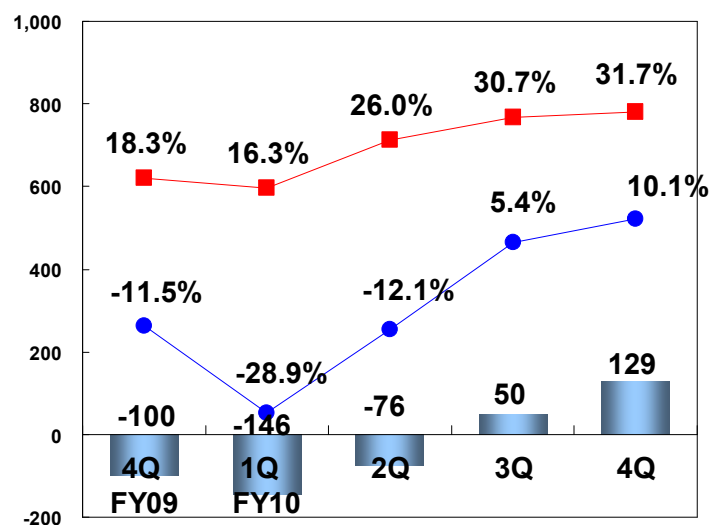


事業の種類別セグメント情報

産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、
太陽電池製造装置、その他)

(単位: 億円)

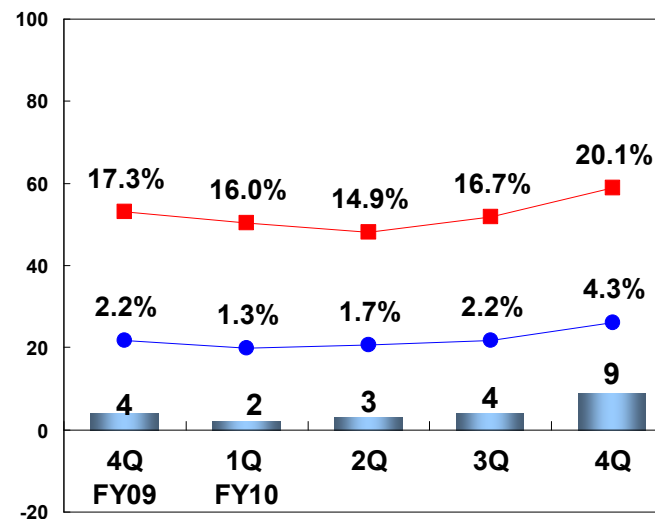


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

電子部品・情報通信機器

(半導体製品、その他電子部品、
コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア)

(単位: 億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

*セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



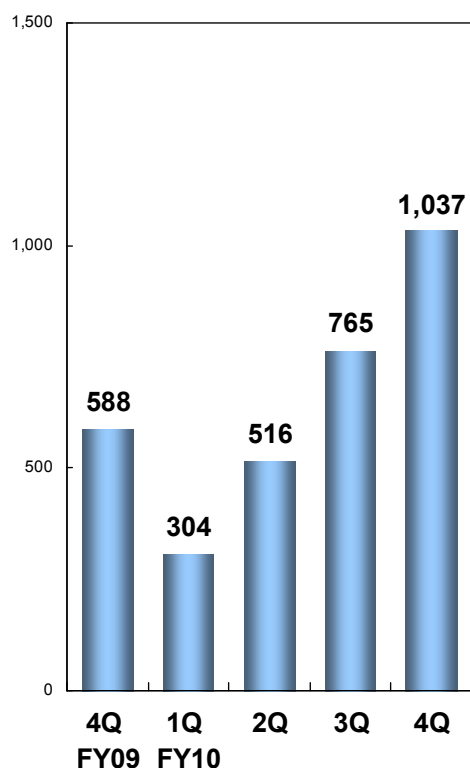
2010年3月期 決算(連結)

部門別売上高

SPE部門

(半導体製造装置)

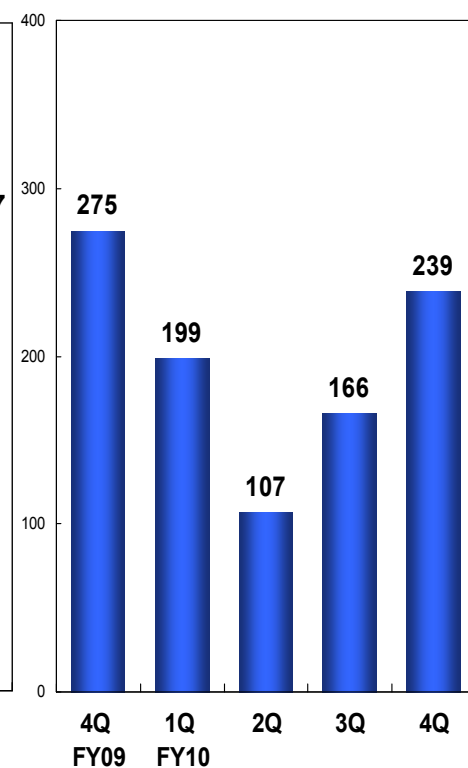
(単位: 億円)



FPD/PVE部門

(FPD製造装置/
太陽電池製造装置)

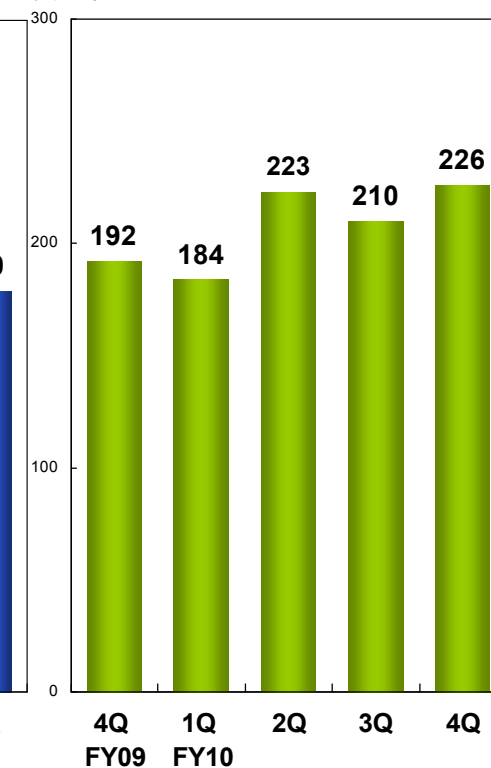
(単位: 億円)



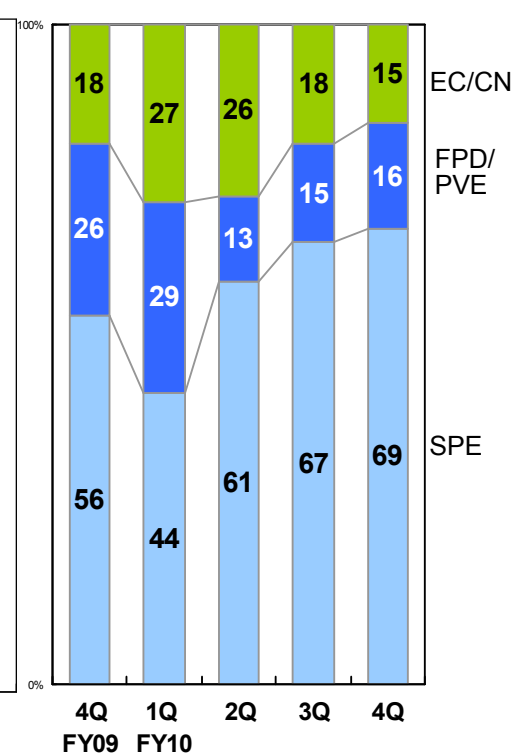
EC/CN部門

(電子部品・情報通信機器)

(単位: 億円)



部門別構成比



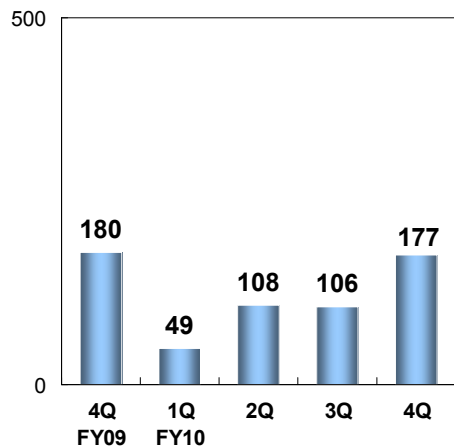
*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(FY10/4Q売上高1億円)。



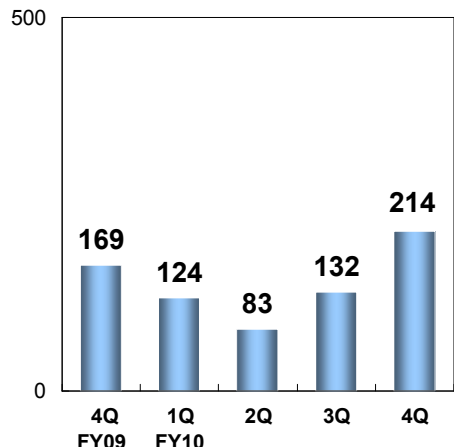
SPE部門地域別売上高

(単位:億円)

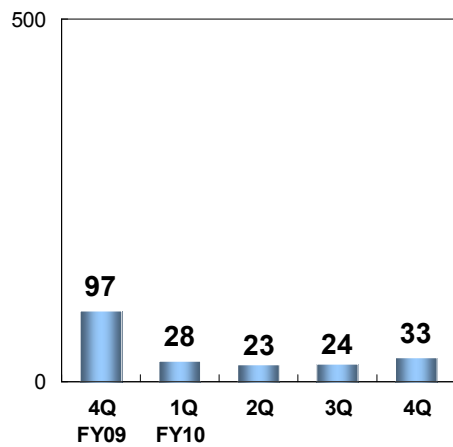
日本



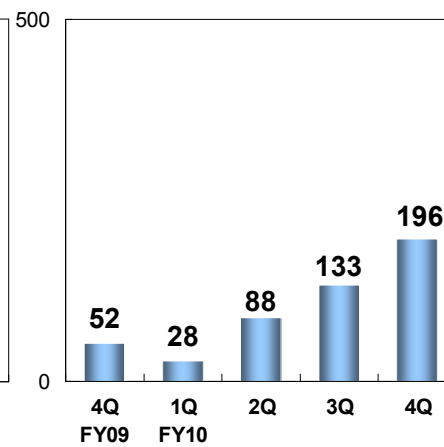
米国



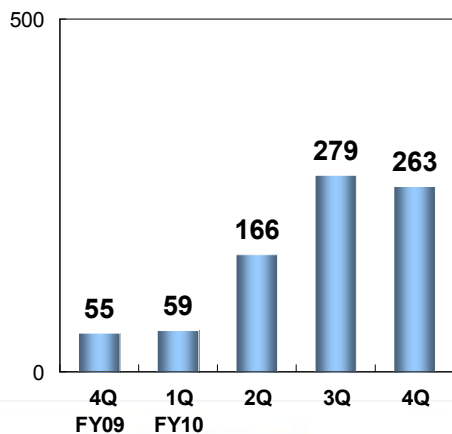
欧州



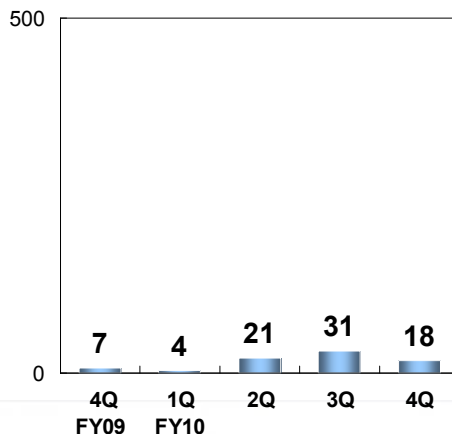
韓国



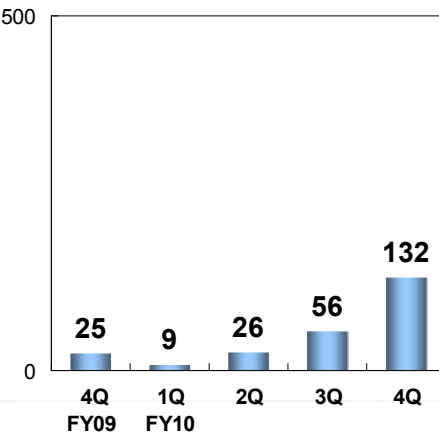
台湾



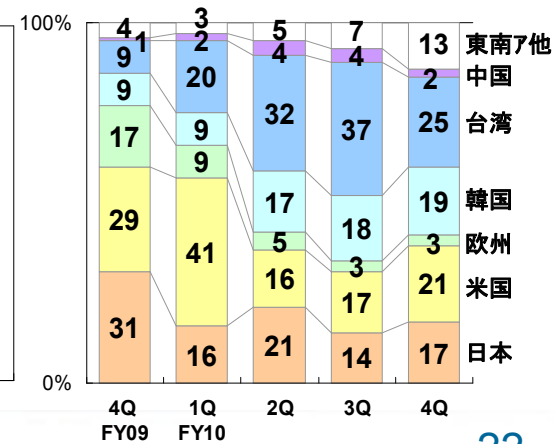
中国



東南アジア



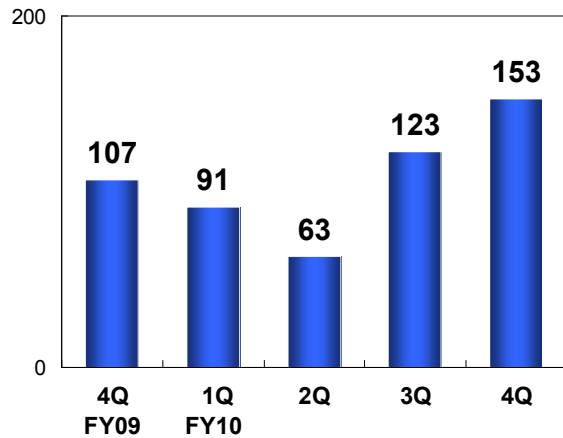
地域別構成比



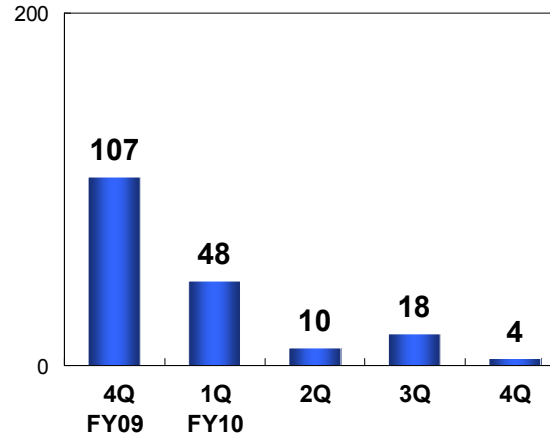
FPD/PVE部門地域別売上高

(単位:億円)

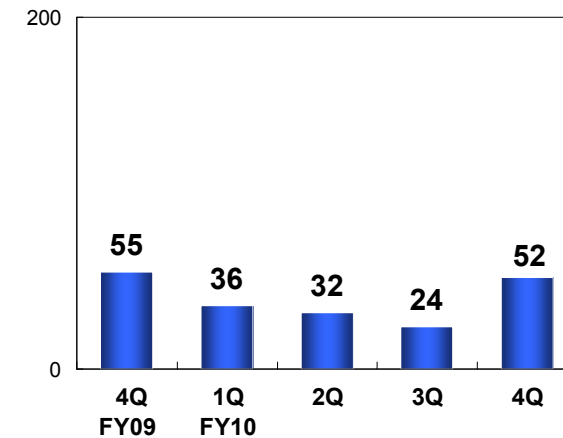
日本



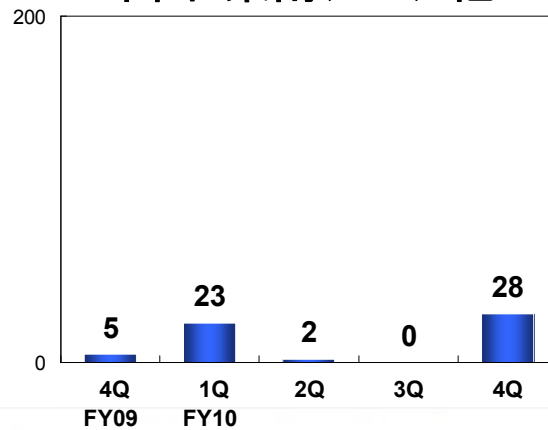
韓国



台湾



中国・東南アジア他



地域別構成比

